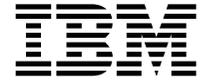


# IBM Power System S821LC (8001-12C)クイック・インス トール・ガイド



---

## IBM Power® System S821LC (8001-12C) クイック・インス トール・ガイド

IBM Knowledge Center は、[http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/8001\\_12c\\_landing.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/8001_12c_landing.htm) からオンラインで使用できます。

- 主要な部品に対する作業を開始する前に、予防措置と手順に関するすべての説明をお読みください。
- システムおよび部品に対して作業を行うときは、静電気の放電 (ESD) の正しい手順を使用してください。IBM は、機器に損傷を与えるおそれがないよう、手袋と帯電防止リスト・ストラップを装着することをお勧めしています。

8001-12C 情報: <https://ibm.biz/8001-12CQR>

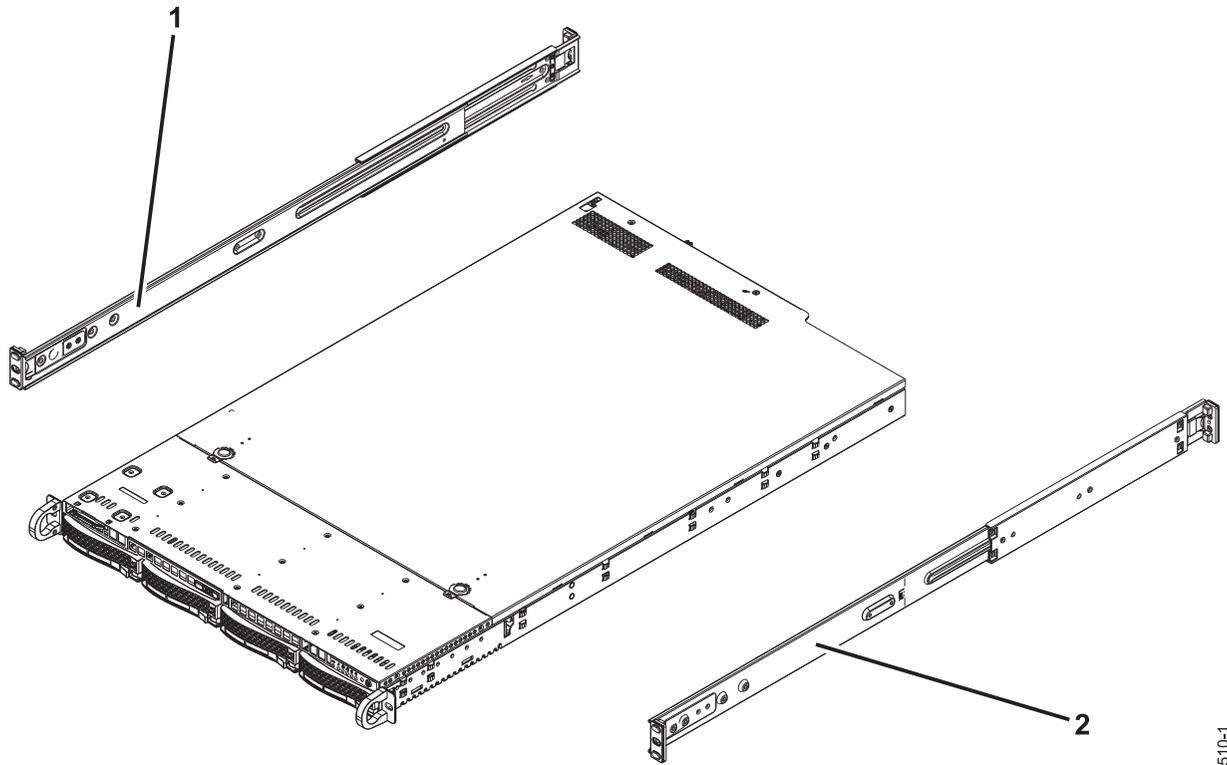


### 8001-12C の部品

現場交換可能ユニット (FRU) の部品番号を見つけるには、次の情報を使用します。

発注する部品の部品番号を特定したら、Advanced Part Exchange Warranty Service にアクセスしてください。登録が必要です。部品番号を特定できない場合には、Contacting IBM® service and support にアクセスしてください。

## ラック最終アセンブリー



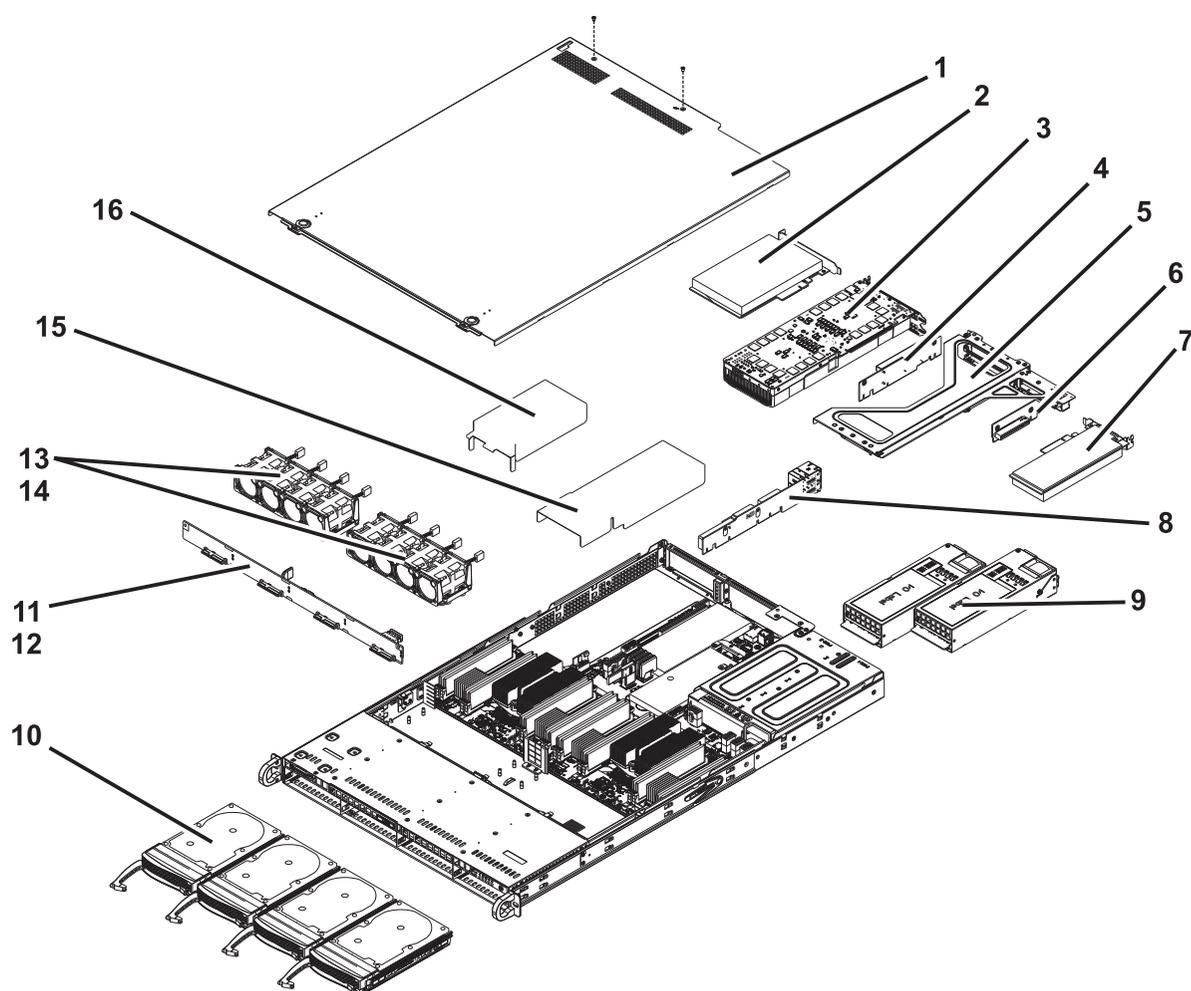
P8E1C0510-1

図 1. ラック最終アセンブリー

表 1. ラック最終アセンブリーの部品番号

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
1	MCP-290-00052-0N	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。
2	MCP-290-00052-0N	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。

## システム部品



P8EIQ511-2

図 2. システム部品

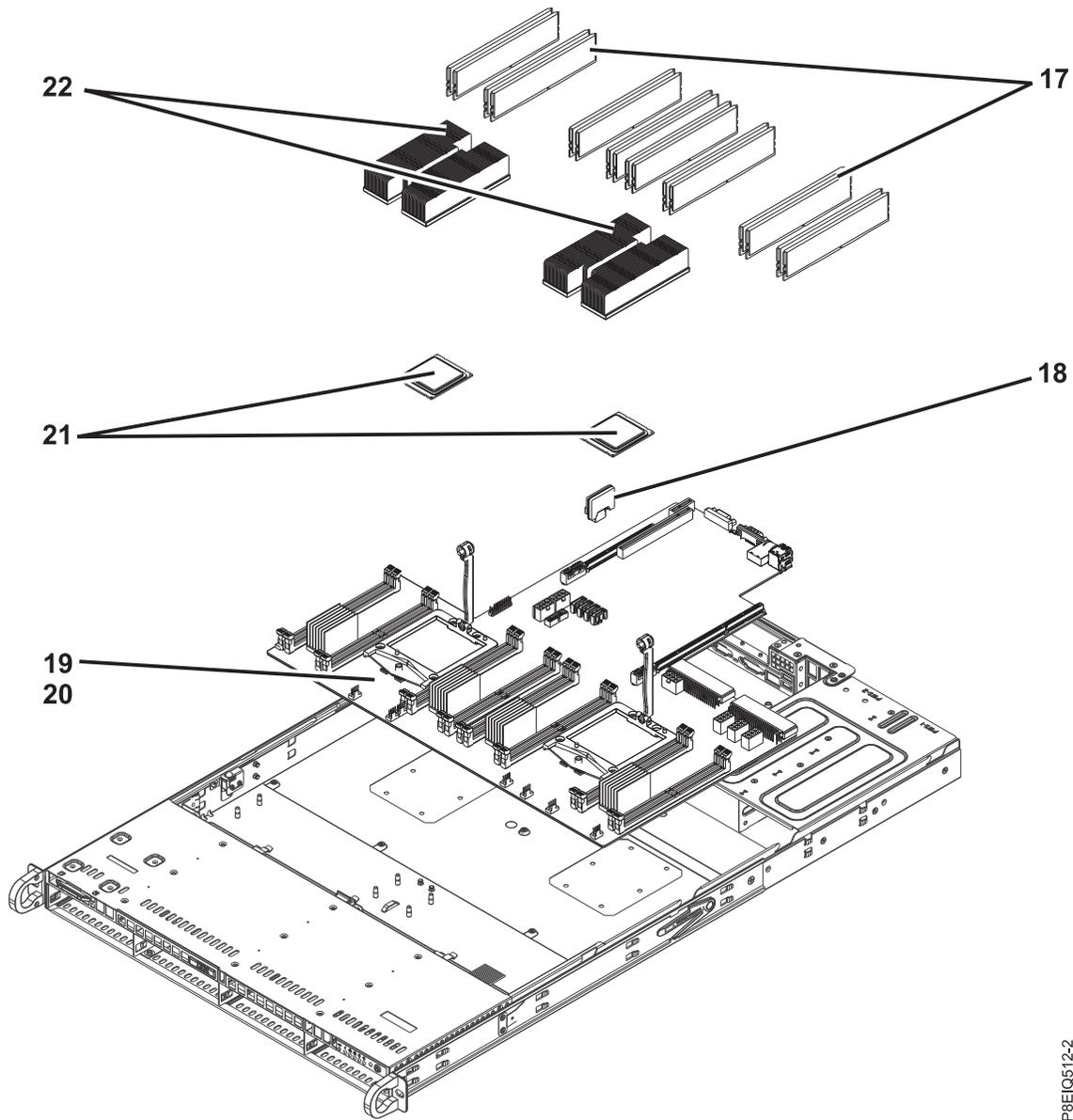
表 2. システム部品

索引番号	部品番号	アセンブリ当たりのユニット数	説明
1		1	トップ・カバー・アセンブリー
		2	ねじ
2		2	PCIe アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-12C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
3		1	GPU。GPU のフィーチャー・タイプを使用して、8001-12C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
4	RSC-W-66P	1	PCIe アダプターまたは GPU 用の PCIe ライザー。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-12C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
5		1	PCIe ケージ
6	RSC-R1UW-E8R	1	PCIe ライザー
7		1	PCIe アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-12C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
8	AOC-UR-i4XTF	1	1U UIO NIC PCIe アダプター (統合 4 ポート 10 GbE Base-T、Intel XL710、および CAPI 搭載) 注: この PCIe アダプターは、PCIe ライザーとしても機能します。
9	PWS-1K02A-1R	2	電源装置
10	HDD-A2000-ST2000NM003401	4	2 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ

表 2. システム部品 (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリ当たりのユニット数	説明
10	HDD-A4000-ST4000NM003401 または HDD-A4TB- HUS726040AL5210	4	4 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
10	HDD-A6000-ST6000NM003401	4	6 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
10	HDD-A8000-ST8000NM0075	4	8 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
10	HDD-A4000-ST4000NM0075	4	4 TB 3.5 型自己暗号化 SAS ディスク・ドライブ
10	HDD-A8000-ST8000NM0095	4	8 TB 3.5 型自己暗号化 SAS ディスク・ドライブ
10	HDD-T2000-ST2000NM002401	4	2 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
10	HDD-T4000-ST4000NM002401	4	4 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
10	HDD-T6000-ST6000NM002401	4	6 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
10	HDD-T8000-ST8000NM0055	4	8 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
10	HDS-KIT-2A-1920-IB001	4	1.9 TB Small-Form Factor SAS ソリッド・ステート・ドライブ (1 日あたりのドライブ書き込み 1 回)
10	HDS-KIT-2A-3840-IB001	4	3.8 TB Small-Form Factor SAS ソリッド・ステート・ドライブ (1 日あたりのドライブ書き込み 1 回)
10	HDS-KIT-2T-160-IB001	4	160 GB スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
10	HDS-KIT-2T-240-IB001	4	240 GB スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
10	HDS-KIT-2T-960-IB001	4	960 GB スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
10	HDS-KIT-2T-1900-IB001	4	1.9 GB スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
10	HDS-KIT-2T-3800-IB001	4	3.8 GB スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
10	HDS-KIT-3N-800-IB001	4	800 GB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
10	HDS-KIT-3N-1200-IB001	4	1.2 TB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
10	HDS-KIT-3N-1600-IB001	4	1.6 TB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
10	HDS-KIT-3N-2000-IB001	4	2.0 TB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
10	HDS-KIT-5N-800-IB001	4	800 GB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 5 ドライブ書き込み)
10	HDS-KIT-5N-3200-IB001	4	3.2 TB スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 5 ドライブ書き込み)
11	BPN-SAS3-815TQ-N4	1	ディスク・ドライブ・バックプレーン
12		2	ねじ
13	FAN-0141L4	8	ファン
14		2	ファン・ホルダー
15	MCP-310-81909-0B	1	CPU 1 エア・パッフル
16	MCP-310-81908-0B	1	CPU 2 エア・パッフル

## 追加システム部品



P8EIO512-2

図 3. 追加システム部品

表 3. 追加システム部品

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
17	MTA9ASF51272PZ-2G3B1	16	4 GB、2400 MHz 1RX8 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA9ASF1G72PZ-2G3B1	16	8 GB、2400 MHz 1RX8 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA18ASF2G72PZ-2G3B1	16	16 GB、2400 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA36ASF4G72PZ-2G3A1	16	32 GB、2400 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	M393A1G40DB0-CPB	16	8 GB、2133 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A2G40DB0-CPB	16	16 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A4K40BB0-CPB	16	32 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	HMA41GR7AFR4N-TF	16	8 GB、2133 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*
	HMA42GR7AFR4N-TF	16	16 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*
	HMA84GR7MFR4N-TFT1	16	32 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*

表 3. 追加システム部品 (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
18	SSD-DM064-PHI	2	64 GB SATA ドライブ・オン・モジュール (DOM)
	SSD-DM128-SMCMVN1	2	128 GB SATA ドライブ・オン・モジュール (DOM)
19	MBD-P8DTU	1	システム・バックプレーン
20		14	ねじ
21	00UL867	2	8 コア 2.328 GHz システム・プロセッサ・モジュール
	00UL865	2	10 コア 2.095 GHz システム・プロセッサ・モジュール
22	SNK-P0052P-IB001	2	ヒート・シンク・キット (ヒート・シンクおよび熱伝導材料が含まれています)

\*8001-12C システム内のメモリーはすべて、同じサイズのもので、同じ製造業者のものでなければなりません。8001-12C システムでは、異なるサイズのメモリーの混合および異なる供給業者からのメモリーの混合はサポートされません。

## 背面ポート

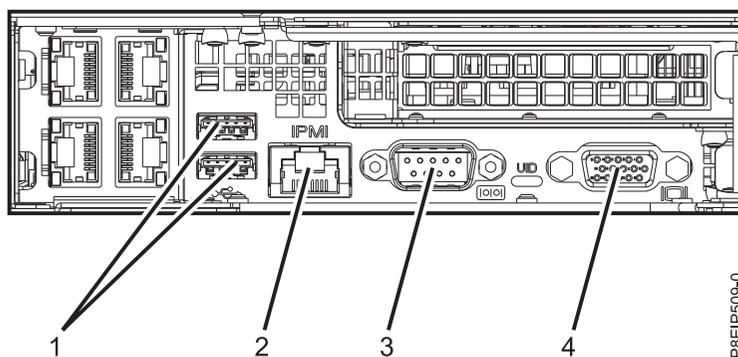


図 4. 背面ポート

表 4. 入出力ポート

ID	説明
1	USB 2.0 (キーボードとマウスに使用)
2	Ethernet Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
3	Serial IPMI
4	Video Graphics Array (VGA) (モニターに使用)。1024 x 768、60 Hz VGA 設定のみがサポートされます。最大 3 メートルのケーブルのみがサポートされます。現時点でサポートされているのは、テキスト・ベース機能のみです。

## 取り付けと取り外し

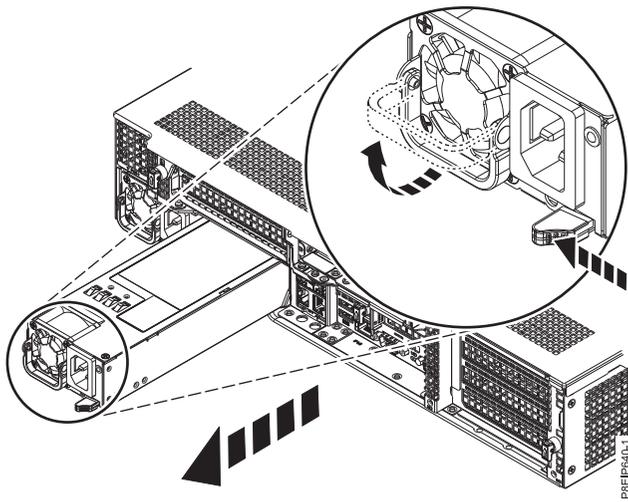


図 5. システムから電源装置を取り外す

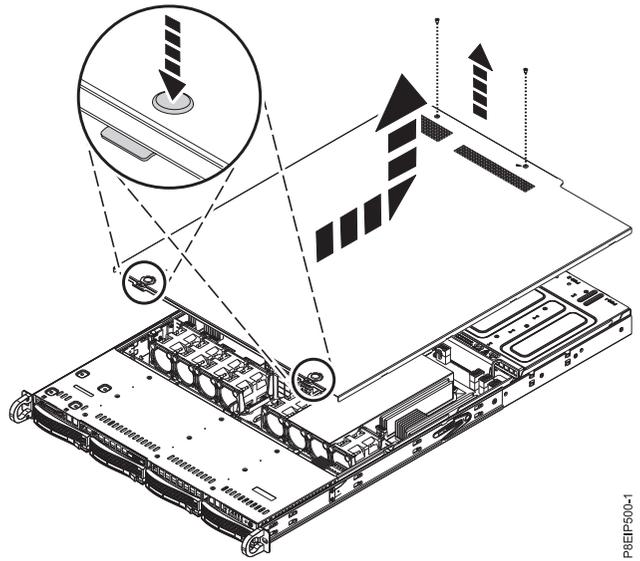


図 6. カバーを解放して開く

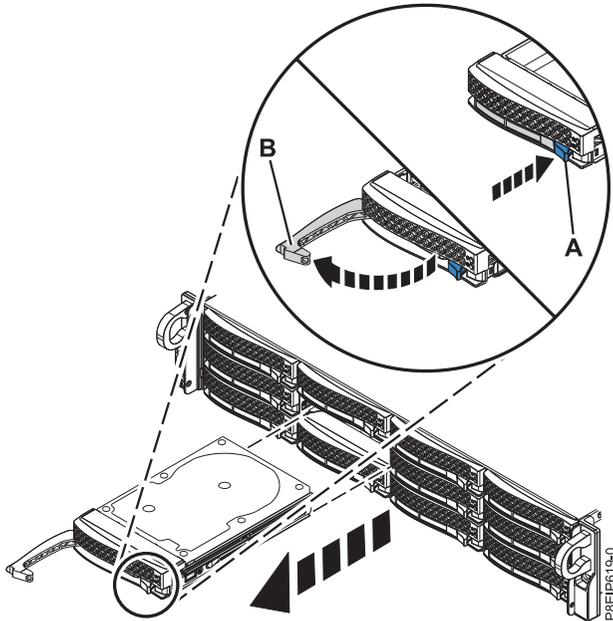


図 7. ドライブの取り外し

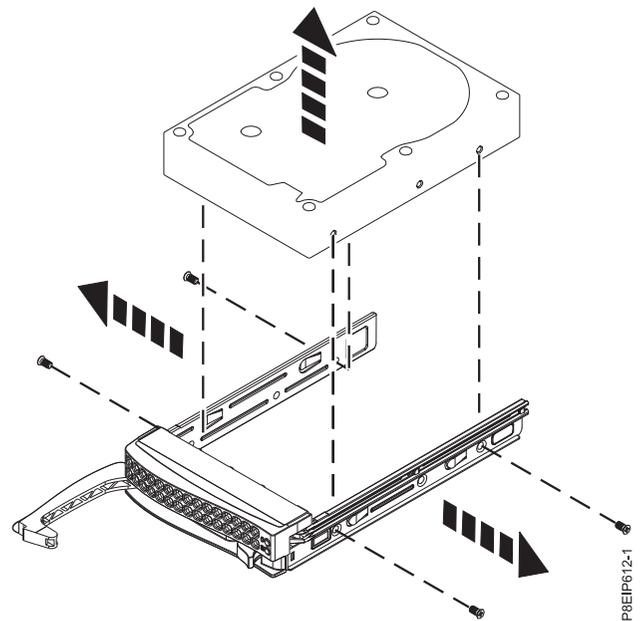


図 8. トレイからの 3.5 型ドライブの取り外し

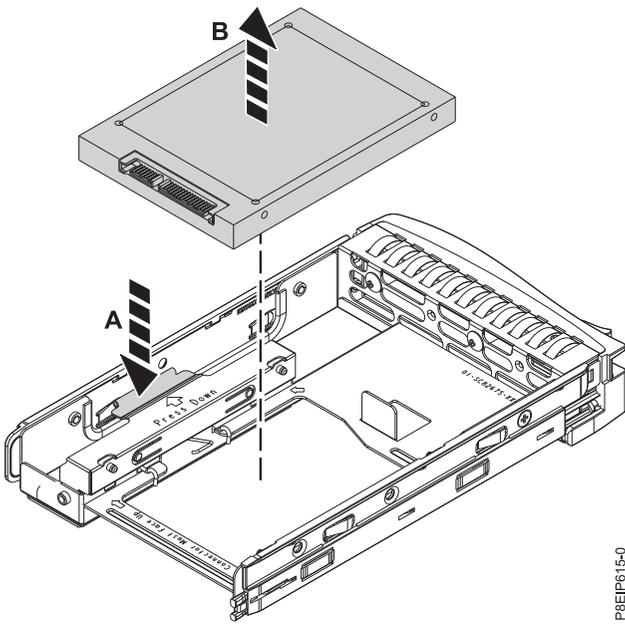


図 9. トレイからの 2.5 型ドライブの取り外し

P8EIP615-0

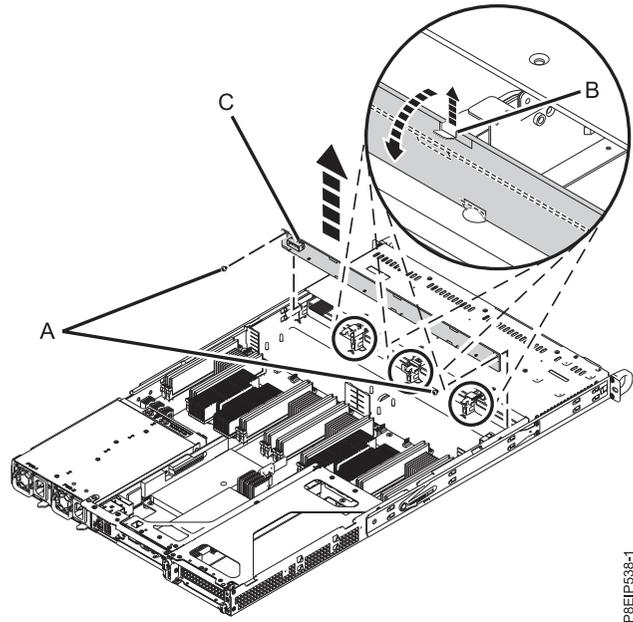


図 10. ディスク・ドライブ・バックプレーンとねじの取り外し

P8EIP538-1

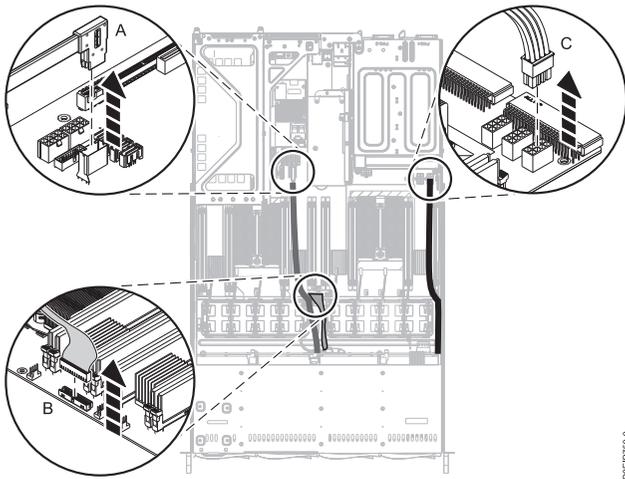


図 11. ドライブの信号ケーブルと電源ケーブルの切り離し

P8EIP700-0

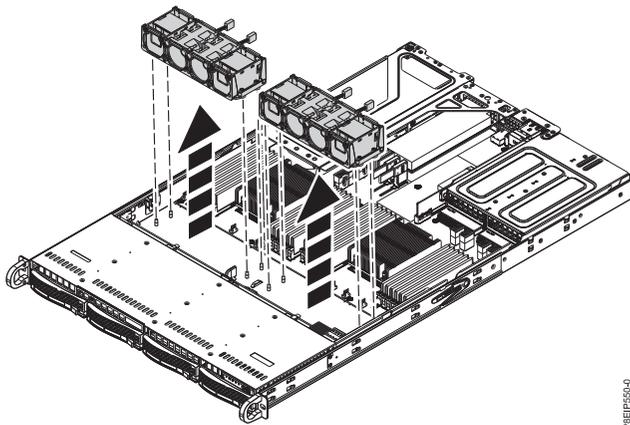


図 12. ファン・ホルダーの取り外し

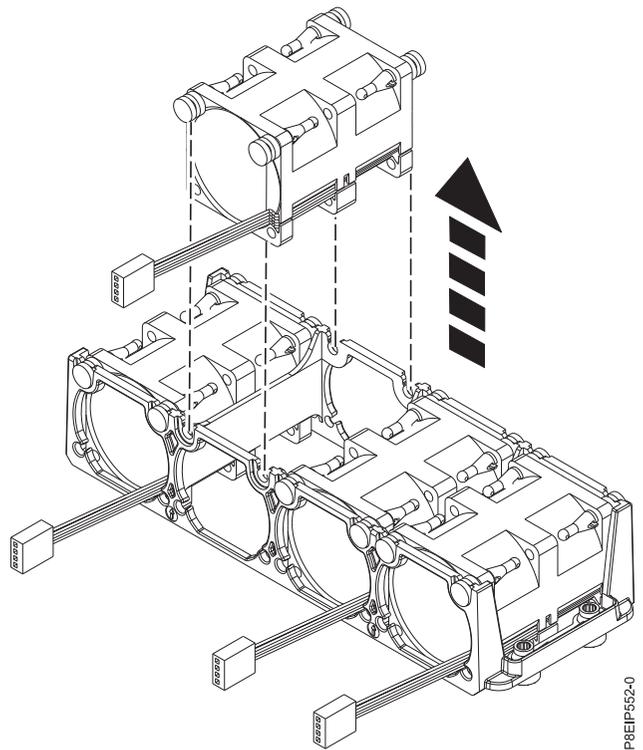


図 13. ファンの取り外し

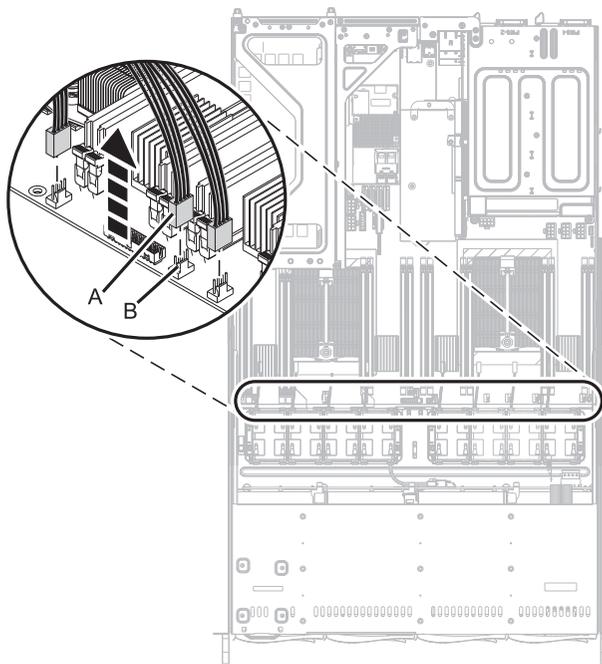


図 14. ファン・ケーブルの切り離し

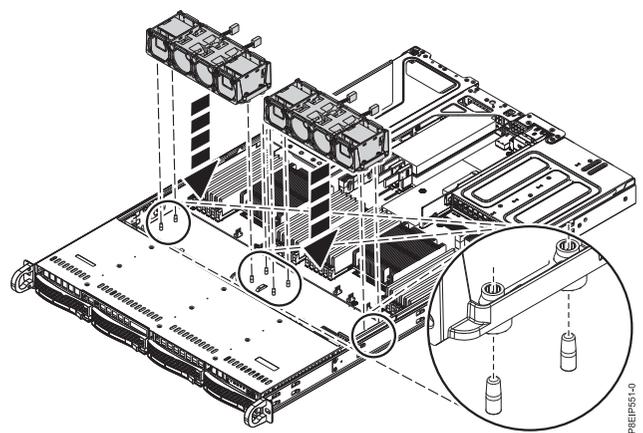


図 15. ファン・ホルダーの位置合わせ

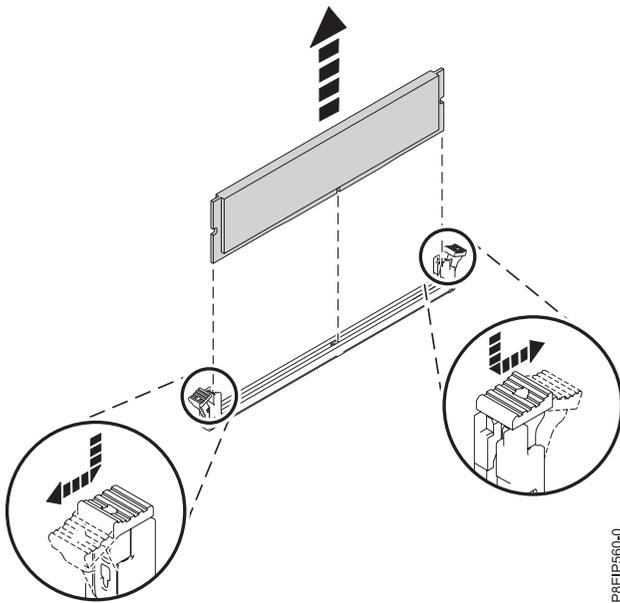


図 16. メモリーの取り外し

P8EIP560-0

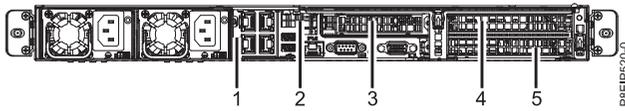


図 18. 8001-12C PCIe アダプターの位置

P8EIP520-0

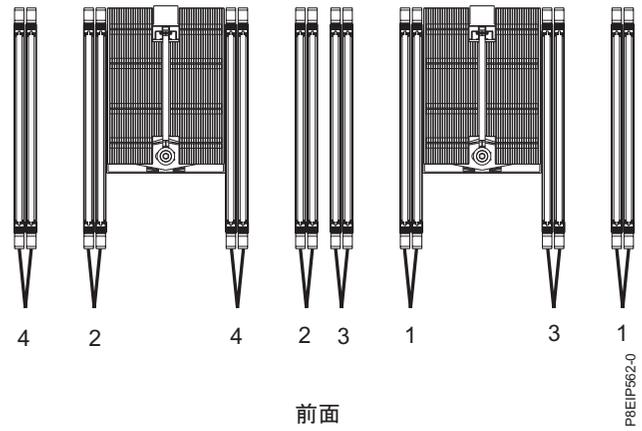


図 17. メモリー・スロット位置と差し込み順序

P8EIP562-0

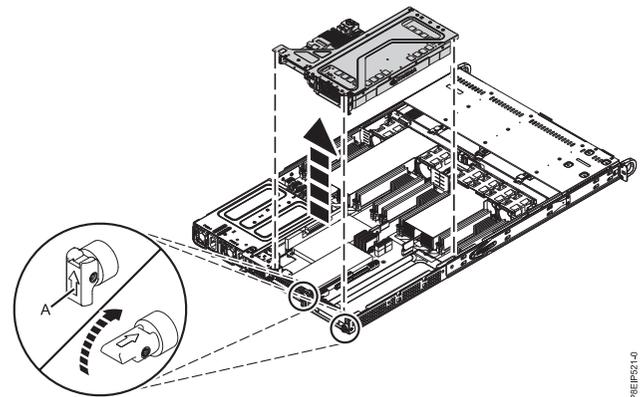


図 19. PCIe ライザーの取り外し

P8EIP521-0

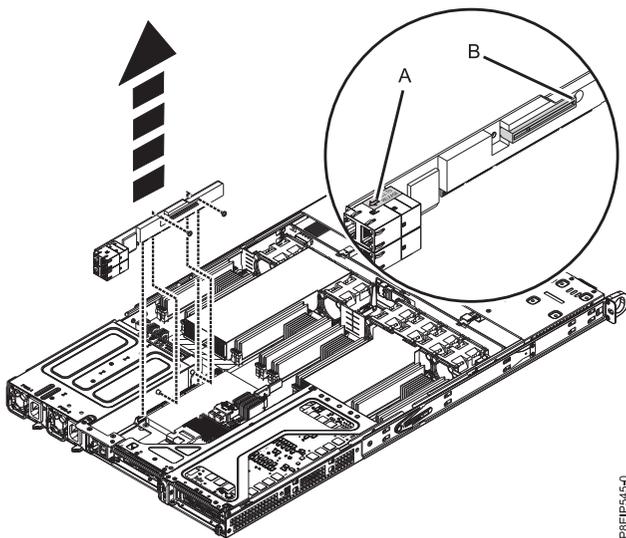


図 20. PCIe ライザーのねじの取り外し

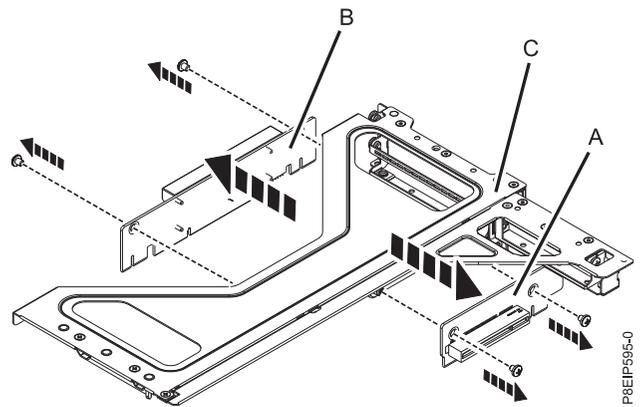


図 21. アダプター・ケージからの PCIe ライザー・カードの取り外し

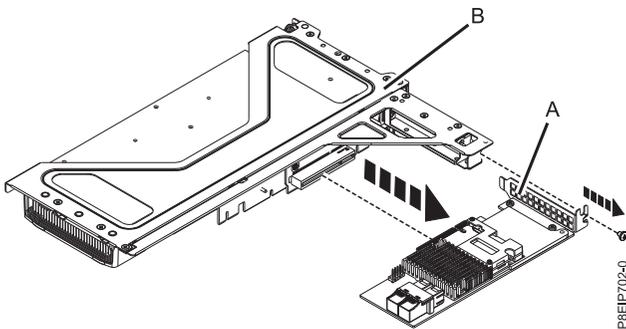


図 22. ライザーの位置 3 からの PCIe アダプターの取り外し

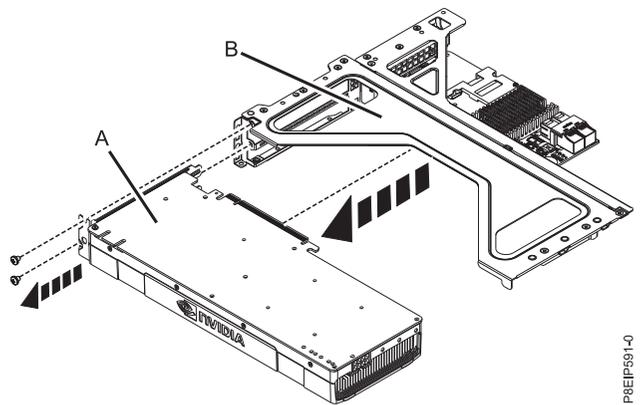


図 23. ライザーからの GPU の取り外し

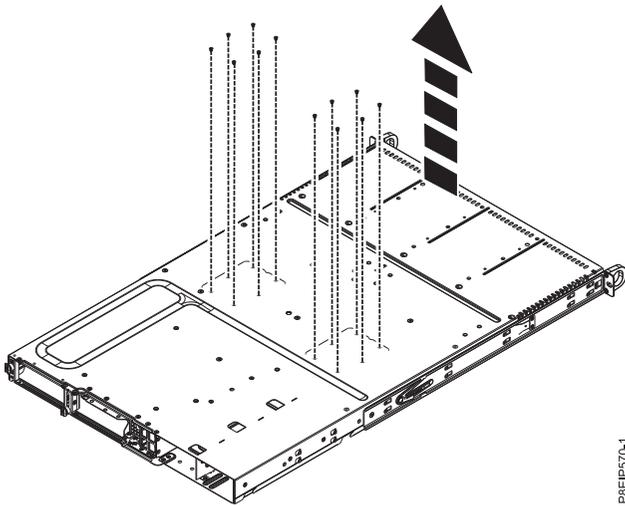


図 24. シャーシの下部にあるプロセッサ・ソケットのねじ

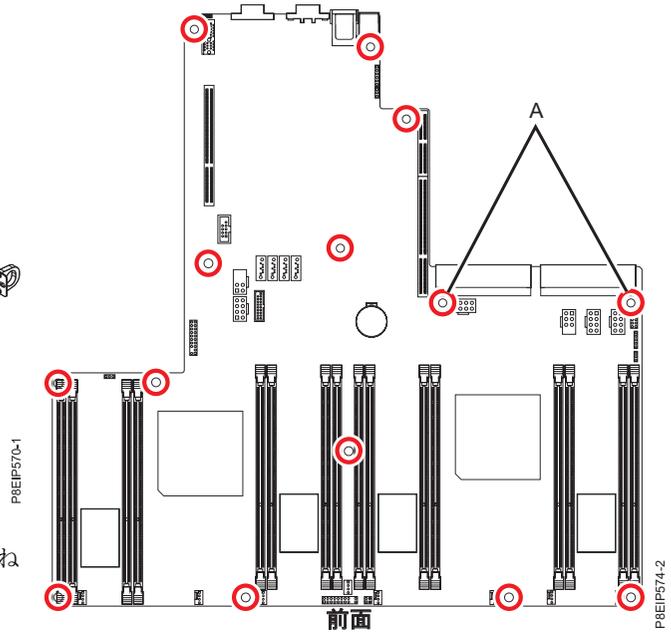


図 25. ねじの位置

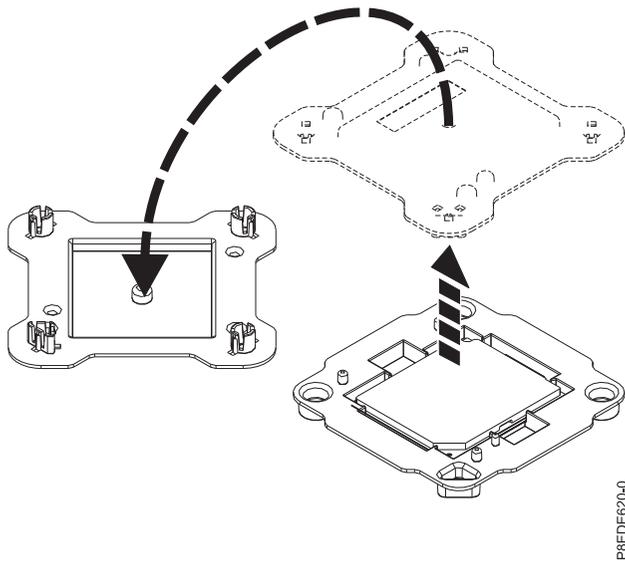


図 26. システム・プロセッサ・モジュールのパッケージを開く

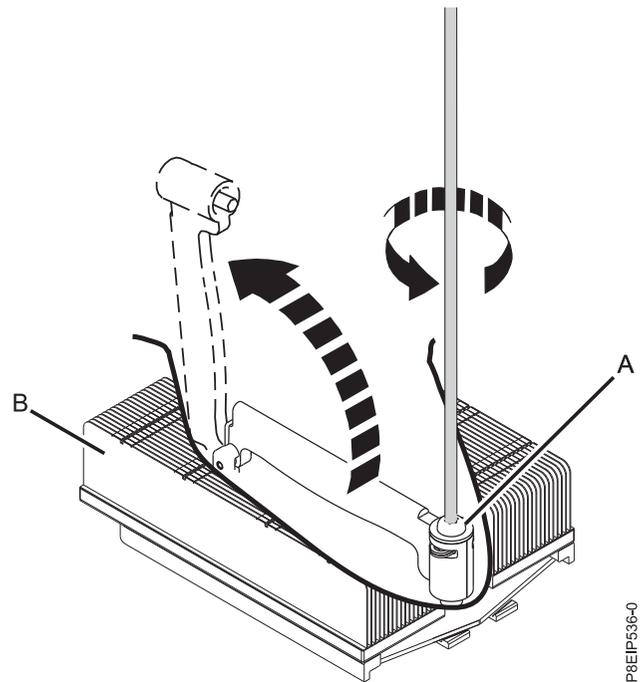


図 27. ヒート・シンク・ロード・アームのねじを締める

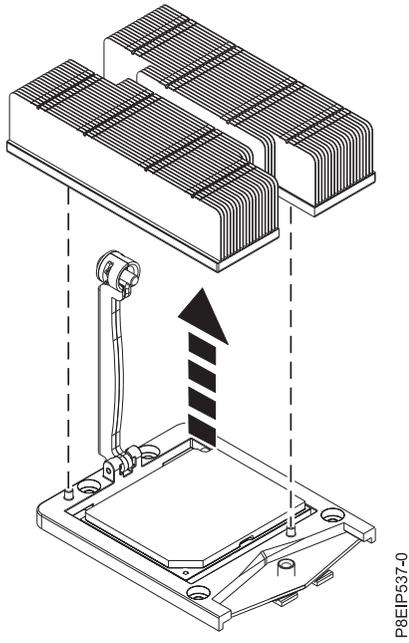


図 28. ヒート・シンクの取り外し

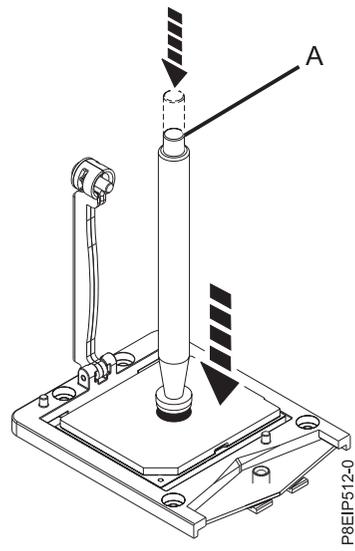


図 29. システム・プロセッサ・モジュールへの真空ペンのロック

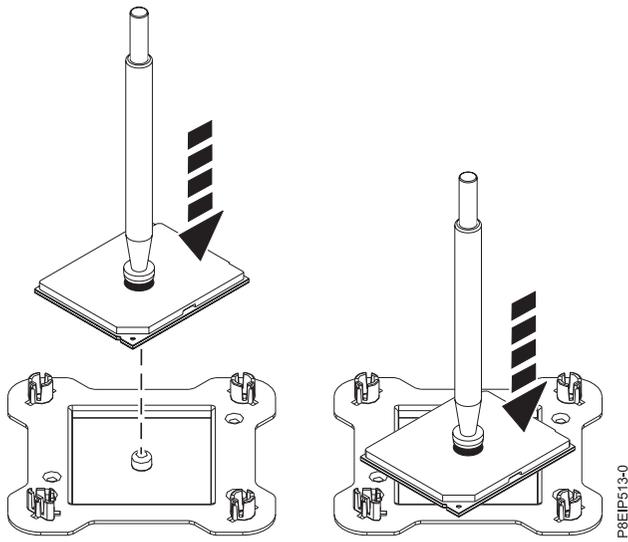


図 30. パッケージのトップ・カバーにプロセッサを斜めに置く

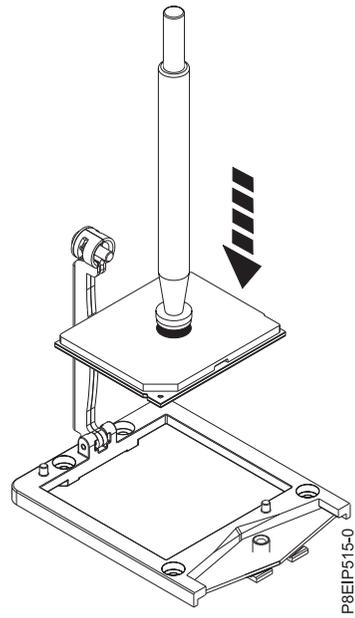


図 31. プロセッサをソケットに下ろす

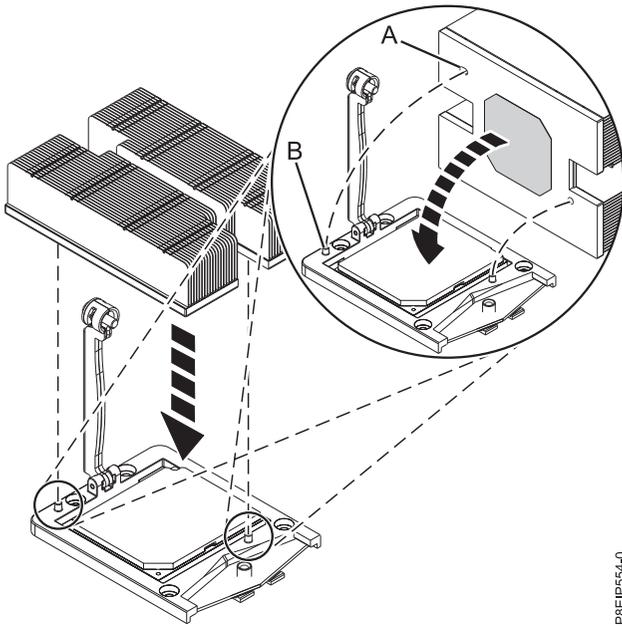


図 32. ヒート・シンクの取り付け

P8EIP554-0

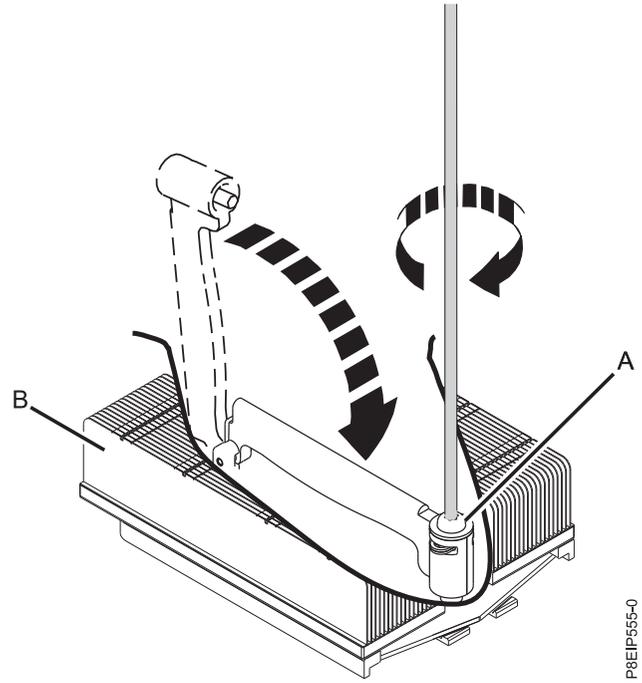


図 33. ロード・アームのねじを締める

P8EIP555-0

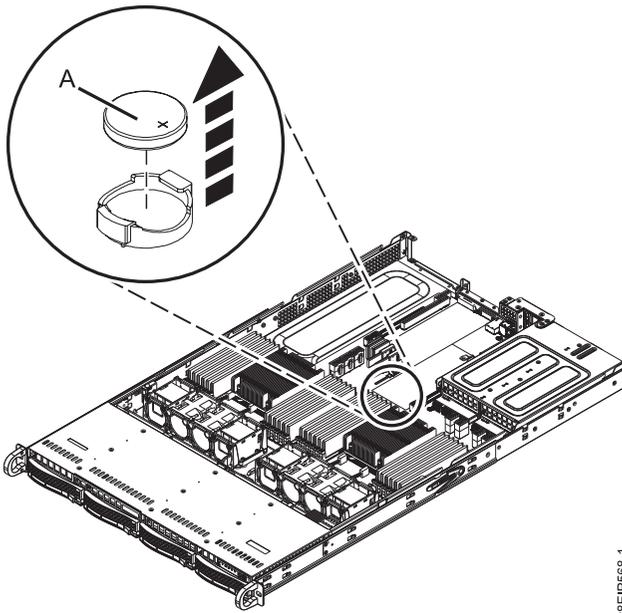


図 34. 時刻バッテリーの位置

P8EIP568-1

---

本書は、POWER8 プロセッサを搭載した IBM Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されません。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

© Copyright IBM Corporation 2016, 2017.